

《亲历中国半导体产业的发展》

图书基本信息

书名：《亲历中国半导体产业的发展》

13位ISBN编号：9787121215780

出版时间：2013-10-1

作者：俞忠钰

页数：376

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《亲历中国半导体产业的发展》

内容概要

本书通过俞忠钰自1958年至今的亲身经历，回顾了中国半导体产业发展中的重大历史事件，阐述了中国半导体产业，尤其是集成电路产业筚路蓝缕的成长历程，并对由此而产生的一些经验或启示进行了认真思考。

《亲历中国半导体产业的发展》

书籍目录

目录

第1章 13所

- 1
- 1.1 引言
- 2
- 1.2 初期的研究工作
- 3
- 1.3 在石家庄的研究工作
- 6
- 1.4 CCD固体摄像传感器
- 9
- 1.5 首次赴美考察
- 12

第2章 878厂

- 37
- 2.1 中国集成电路产业的起步
- 38
- 2.1.1 从晶体管到集成电路的发展
- 38
- 2.1.2 中国集成电路产业的起步
- 39
- 2.1.3 东光电工厂（878厂）的组建
- 40
- 2.2 我在878厂的5年
- 41
- 2.2.1 878厂生产线的引进
- 41
- 2.2.2 我从13所到878厂
- 43
- 2.3 赴法国参加微电子高级研讨会
- 44
- 2.4 受聘电子计算机和大规模集成电路领导小组集成电路组顾问
- 45
- 2.5 向陈云同志汇报
- 47
- 2.6 任职878厂厂长
- 48

第3章 微电子器件局

- 51
- 3.1 任职中国电子器件工业总公司
- 52
- 3.2 组建微电子器件局
- 53
- 3.3 无锡微电子科研生产联合体
- 55
- 3.3.1 742厂引进项目情况与后续发展
- 55

3.3.2 组建无锡微电子科研生产联合体

56

3.4 “七五”集成电路发展战略——厦门会议

57

3.5 推广5微米技术，实现中小规模电路规模化生产

65

3.6 研制开发64K DRAM

70

第4章 无锡微电子工程

91

4.1 背景

92

4.2 无锡微电子工程概览

92

4.3 无锡微电子工程的历史沿革

95

4.3.1 前期启动工作

95

4.3.2 曲折的谈判历程

97

4.3.3 工程的实施

102

4.3.4 简要回顾

106

4.4 经验与反思

107

第5章 科技攻关

113

5.1 “六五”科技攻关计划

114

5.2 CAD中心建设的前期工作

115

5.2.1 沈梅女士和米德教授

115

5.2.2 北京集成电路设计中心

116

5.3 组建ICCAD专家委员会

119

5.4 自力更生开发“熊猫系统”

121

5.5 “七五”科技攻关计划

125

5.5.1 大规模集成电路技术

127

5.5.2 计算机系统

129

5.5.3 计算机软件

129

5.5.4 通信技术

130	
5.5.5	新型结构材料与功能材料
130	
5.6	“八五”科技攻关成果
131	
5.6.1	微电子技术
131	
5.6.2	计算机与软件技术
136	
5.6.3	电力电子器件
137	
5.6.4	电子信息材料
137	
5.6.5	高清晰度电视关键技术
138	
5.6.6	空中交通管制系统
138	
第6章	908工程
151	
6.1	908工程的背景
152	
6.2	908工程的主要内容
152	
6.3	908工程的选址
158	
6.4	908工程的实施
161	
6.4.1	908工程的实施方案
161	
6.4.2	邹家华副总理的指示
166	
6.4.3	908工程正式启动
170	
6.4.4	908工程的进展
172	
第7章	909工程
183	
7.1	909工程概貌
184	
7.2	909工程的对外谈判工作
187	
7.2.1	概述
187	
7.2.2	广泛接触
187	
7.2.3	深入谈判
196	
7.2.4	货比三家
198	

7.2.5 与NEC谈判	203
7.3 909工程的市场调研	205
7.3.1 市场调研的总体思路	205
7.3.2 1995年的世界集成电路市场	205
7.3.3 1995年的中国集成电路市场	207
7.3.4 国内主要电子应用产品市场	208
7.3.5 开发产品的选择	211
7.3.6 产品开发策略	212
7.3.7 产品开发的内容	213
7.3.8 支持产品开发的配套政策	214
7.4 上海华虹NEC公司生产线	216
7.4.1 前期准备工作	216
7.4.2 与NEC合作	219
7.5 909工程的集成电路设计公司	223
7.5.1 909工程对集成电路设计的布局	223
7.5.2 中国华大集成电路设计中心	225
7.5.3 上海华虹集成电路有限责任公司	228
7.5.4 北京华虹集成电路设计有限公司	228
第8章 中国半导体行业协会	249
8.1 任职中国半导体行业协会	250
8.2 《中国半导体产业调研报告》（2002）	254
8.3 加入世界半导体理事会	256
8.3.1 背景	256
8.3.2 开始谈判	257
8.3.3 过程艰难	

258	
8.3.4	美国之行——转机
258	
8.3.5	为什么要加入WSC
260	
8.3.6	签署备忘录，参加WSC
261	
8.3.7	首次参加WSC会议
263	
8.3.8	一点感想
265	
8.4	中国国际半导体博览会及高峰论坛（IC China）
266	
8.5	中国半导体产业的快速发展
275	
8.5.1	简要回顾
275	
8.5.2	鼓励集成电路产业发展的政策
276	
8.5.3	中国半导体产业进入快速发展期
279	
8.5.4	中国集成电路制造业的快速发展
283	
8.5.5	集成电路设计业的迅速成长
286	
8.5.6	国家重大科技专项
287	
第9章	对中国集成电路产业发展的思考
327	
9.1	引言
328	
9.2	全球IT产业发展与集成电路市场
328	
9.2.1	IT产业发展与集成电路市场
328	
9.2.2	全球集成电路技术发展趋势
329	
9.3	中国集成电路产业发展面临机遇与挑战
332	
9.3.1	中国集成电路技术与产业发展现状
332	
9.3.2	中国集成电路产业发展面临着机遇与挑战
333	
9.4	对中国集成电路产业发展的思考
335	
9.4.1	加速拓展国产IC生态链，开拓高端芯片产品市场
335	
9.4.2	组织模式创新与制造技术水平的持续提升相结合
336	

《亲历中国半导体产业的发展》

9.4.3 中国集成电路产业要从追赶式发展转变为创新型发展

336

9.4.4 国家产业政策扶持和市场驱动相结合

337

附录A 俞忠钰简历

339

附录B 俞忠钰主要论著

341

附录C 补遗

353

附录D 高扬着的是精神

355

《亲历中国半导体产业的发展》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com